

06;11;12

## ОСОБЕННОСТИ ЭПИТАКСИАЛЬНОГО РОСТА CeO<sub>2</sub> ПЛЕНОК НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ

© O. В. Смольский, В. В. Мамутин, Н. Ф. Картенко,  
Д. В. Денисов, П. С. Копьев, Б. Т. Мелех

Решение задачи получения структурно-совершенных ВТСП пленок и гетероструктур на их основе требует изорешеточных подложек или промежуточных согласующих слоев. С этой точки зрения перспективно применение диоксида церия (CeO<sub>2</sub>), и прежде всего, в качестве буферного слоя между YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> (YBCO) и кремнием. Материал стабилен до высоких температур, имеет малое рассогласование по параметру решетки с YBCO и кремнием, равное 0.8% и 0.35% соответственно, и близкий к YBCO коэффициент термического расширения [1–3].

В настоящее время наиболее изученным методом получения пленок CeO<sub>2</sub> является рост на нагретых выше 700°C подложках Si в потоке кислорода из молекулярных пучков CeO<sub>2</sub>, образуемых лазерным [2,4] или электронно-лучевым [5] испарением мишени CeO<sub>2</sub>. Хотя структурно-совершенные пленки с ориентацией (111) были получены в широком интервале температур подложки (150–900)°C [6], рост слоев с ориентацией (100), как наиболее подходящих для с-ориентированных YBCO пленок [5], оказался более сложной задачей. В лучшем случае сообщалось о получении на 4°-разориентированных Si (100) подложках пленок CeO<sub>2</sub> (110) с фасетированной поверхностью [7].

В данной работе представлены результаты исследования эпитаксиального роста CeO<sub>2</sub> пленок на кремниевых подложках методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ). При этом особое внимание уделено оптимизации технологических параметров с целью получения CeO<sub>2</sub> пленок с ориентацией (100) для последующего их использования в качестве буферных слоев в структурах кремний-диэлектрик-YBCO.

Рост пленок CeO<sub>2</sub> на кремниевых подложках с ориентациями (100) и (111) проводился в технологическом модуле высоковакуумной установки "Supra-32" фирмы Riber (базовое давление  $5 \cdot 10^{-10}$  Тор). После стандартной химической подготовки подложки помещались в модуль, где перед ростом диэлектрических пленок поверхность кремния очищалась от естественного окисла. Для этого Si нагревался до температуры  $\sim 700^\circ\text{C}$  и выдерживался в слабом потоке кремния. В результате такой обработки формировалась

атомарно-гладкая реконструированная поверхность, качество которой контролировалось методом дифракции быстрых электронов (ДБЭ). В случае Si (100) наблюдалось образование двухдоменной реконструированной поверхности ( $2 \times 1$ ), а для Si (111) — реконструкция ( $7 \times 7$ ).

Напыление диэлектрических пленок осуществлялось электронно-лучевым испарением мишени CeO<sub>2</sub>. Скорость напыления измерялась и калиброванно изменялась в пределах (0.2–1.0) Å/с с помощью системы XTC (Thin Film Thickness and Rate Monitor) фирмы Leybold Inficon. Для компенсации потерь кислорода в пленке во время роста использовался источник молекулярного кислорода, поток которого формировался через прецизионный натекатель (диаметр  $\sim 1$  мм), расположенный сбоку на расстоянии 3 см от вращающейся подложки. Оценка давления кислорода вблизи поверхности образца при включенном источнике составляла  $\sim 10^{-3}$  Тор. Кислородостойкий платиновый нагреватель манипулятора позволял нагревать Si подложку до температуры 750° С.

Исследование кристаллической структуры и фазового состава выращенных CeO<sub>2</sub> пленок проводилось методом рентгеноструктурного фазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-2 с использованием CuK $\alpha$ -излучения. Для визуализации дифракционной картины и оценки текстуры пленок использовалась фокусирующая съемка (по Брэггу–Брентано) на плоскую фотопленку с углом фокусировки 15.4°. Это среднее значение углов Брэгга  $\theta_{111}$  и  $\theta_{200}$  CeO<sub>2</sub>, что позволяет одновременно фокусировать рефлексы 111 и 200. С целью изучения на начальных стадиях роста изменения химического состояния интерфейса Si/CeO<sub>2</sub> структур ряд образцов после напыления нескольких монослоев передавались по системе высоковакуумного транспорта в аналитическую камеру, где они исследовались методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Подробности этих экспериментов можно найти в [8].

На рис. 1, а приведена дифрактограмма CeO<sub>2</sub> пленки, выращенной в потоке кислорода на Si (100) подложке при температуре 700° С. На дифрактограмме фиксируется серия рефлексов 111, 222, 333, характерная для CeO<sub>2</sub>, текстурированного по (111). Параметр элементарной ячейки, определенный по этой серии рефлексов, составляет 5.410(2) Å. Текстура по (111) хорошо иллюстрируется характером распределения интенсивности на сфокусированном дифракционном кольце 111 CeO<sub>2</sub> (рис. 1, б). Максимум интенсивности размыт по дуге, что свидетельствует об отклонении осей [111] отдельных кристаллитов от нормали к поверхности. Максимальный угол разброса составляет  $\sim 15^\circ$ .

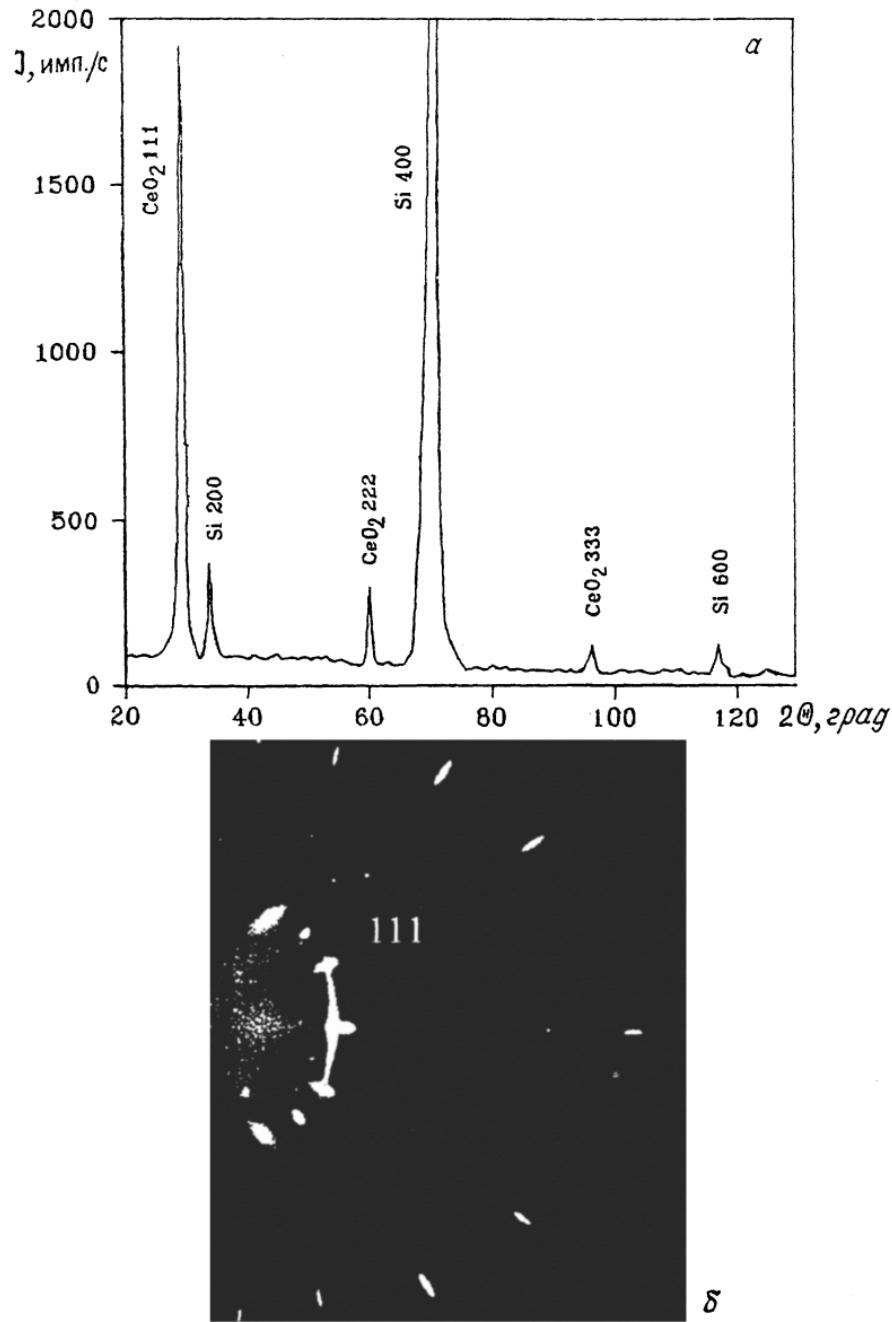


Рис. 1. Дифрактограмма  $\text{CeO}_2$  пленки толщиной  $\sim 900 \text{ \AA}$ , выращенной при температуре  $700^\circ\text{C}$  на  $\text{Si} (100)$  (а). Рентгенограмма (фокусировка по Брэггу-Брентано) этой же пленки (б).

Необходимо отметить, что в этой серии экспериментов ориентация выращенных  $\text{CeO}_2$  пленок не зависела от ориентации кремниевых подложек. Дело в том, что во время выхода электронно-лучевого испарителя на рабочую мощность еще до момента включения кислородного источника

уровень вакуума в ростовом модуле ухудшался до уровня  $\sim 10^{-6}$  Тор. Этот эффект, отмеченный в работах [5,6], происходил вследствие вылета кислорода из разогретой  $\text{CeO}_2$  мишени, что подтверждалось существенным увеличением интенсивности линий 16 и 32 масс на масс-спектрометре. При этом на экране дифрактометра полностью исчезали ДБЭ рефлексы от поверхности кремния и дифракционная картина не восстанавливалась при напылении пленки  $\text{CeO}_2$  до толщины  $\sim 50 \text{ \AA}$ . Эти данные и полученные в дальнейшем результаты РФЭС исследований [8] указывают на формирование тонких аморфных слоев оксидов кремния и церия на начальных стадиях роста при высоких температурах. Образование такой аморфной прослойки в процессе напыления является, на наш взгляд, основной причиной срыва ориентированного роста  $\text{CeO}_2$  на  $\text{Si}(100)$  и последующего формирования плоскости (111), которая соответствует плоскости плотнейшей упаковки для структуры флюорита.

С учетом полученных результатов проведена модификация ростового процесса с целью получения пленок  $\text{CeO}_2$  ориентации (100). Напыление первых монослоев ( $10\text{--}20 \text{ \AA}$ ) проводилось при комнатной температуре, время разгона электронной пушки уменьшено до минимума, и источник кислорода на этой стадии не включался. В этом случае ДБЭ рефлексы не исчезали на начальной стадии и анализ дифракционной картины указывал на "островковый" механизм роста  $\text{CeO}_2$  в этих условиях с сохранением ориентации подложки. В процессе разогрева такой  $\text{Si}(100)/\text{CeO}_2$  структуры наблюдалось существенное изменение дифракционной картины ДБЭ. Точечные рефлексы ДБЭ, которые регистрировались при комнатной температуре, в интервале температур ( $450\text{--}500^\circ\text{C}$ ) трансформировались в полосы. Этот факт объяснялся перестройкой поверхности  $\text{CeO}_2$  и улучшением ее планарности. При этом, по данным РФЭС исследований, на интерфейсе не наблюдалось образование оксида кремния [8]. Последующее выращивание  $\text{CeO}_2$  пленок до толщин ( $500\text{--}1000 \text{ \AA}$ ) проводилось в потоке кислорода при температуре подложки  $\sim 700^\circ\text{C}$ .

Для  $\text{Si}(100)/\text{CeO}_2$  структуры, выращенной представленным выше способом, на рис. 2, *a* приведены рентгеновские дифракционные кривые  $600\text{Si}$  и  $600\text{CeO}_2$ , так как рефлексы 200 и 400 для оксида церия и кремниевой подложки практически совпадают. Факт появления слабого рефлекса  $600\text{CeO}_2$  свидетельствует о наличии текстуры (100) в пленке. Параметр элементарной ячейки  $\text{CeO}_2$  для этого образца составляет  $5.411(1) \text{ \AA}$ , а угол разброса осей [100], определенный по рентгенограмме, —  $\sim 10^\circ$ . Вакуумный отжиг ( $670^\circ\text{C}$ ,

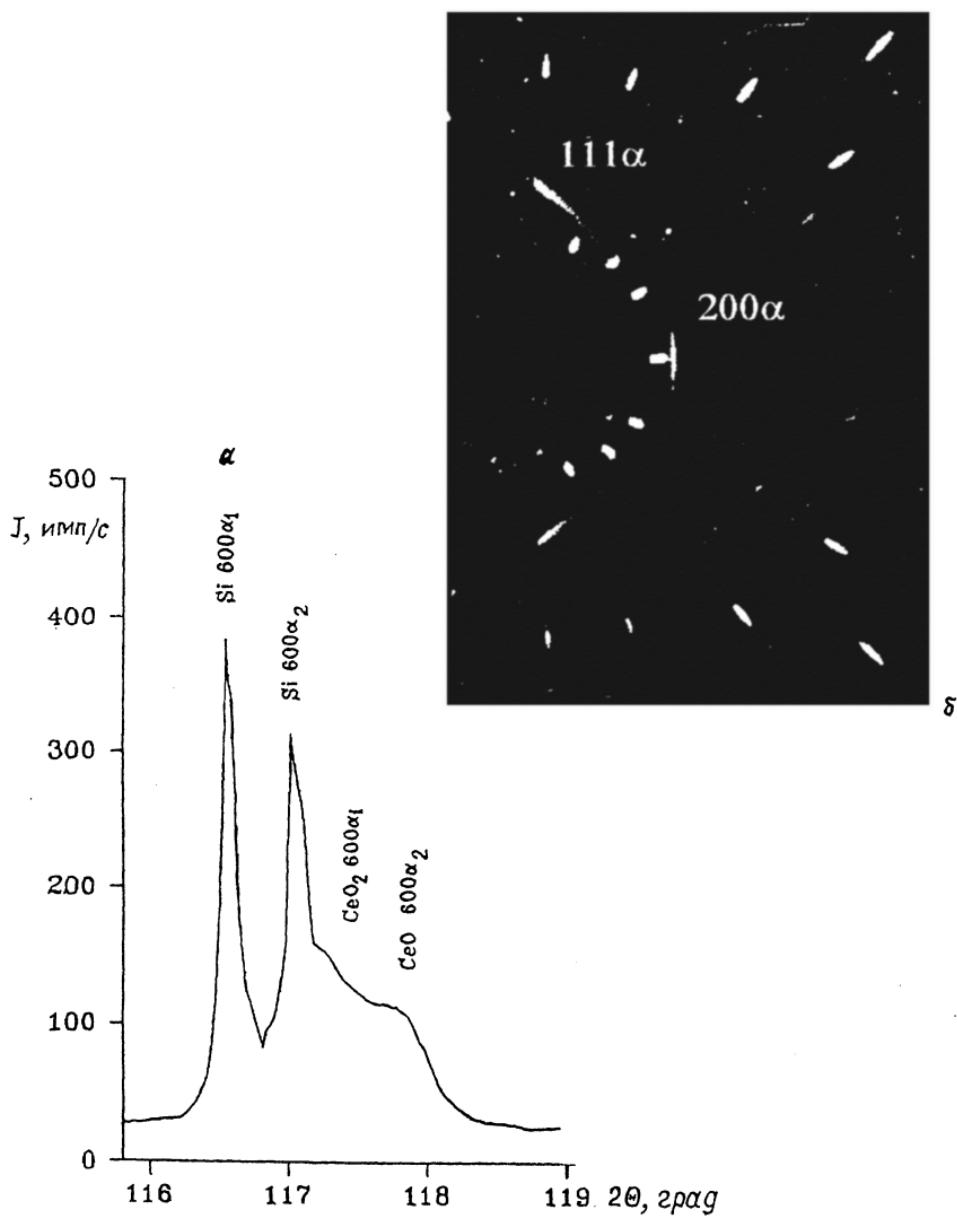


Рис. 2. Фрагмент дифрактограммы CeO<sub>2</sub> пленки толщиной  $\sim 1500 \text{ \AA}$ , первые монослои которой выращивались при комнатной температуре (а); рентгенограмма CeO<sub>2</sub> пленки толщиной  $\sim 500 \text{ \AA}$ , выращенной в таких же условиях, после 12-часового отжига в вакууме при  $670^\circ\text{C}$  (б).

12 ч) текстурированных CeO<sub>2</sub> (100) пленок не ухудшал их кристаллические свойства. На приведенной на рис. 2, б рентгенограмме, соответствующей отожженному образцу, отчетливо видна текстура (100) на дифракционных кольцах

$200_{\alpha,\beta}$ , и отклонение осей [100] от нормали к поверхности также не превышает  $10^\circ$ .

В заключение отметим, что в результате оптимизации процесса роста  $\text{CeO}_2$  нам удалось исключить образование аморфных окислов на начальных стадиях и, как следствие, получить текстурированные  $\text{CeO}_2$  пленки с ориентацией (100).

Работа выполнена в рамках проектов 94018(МПЭ) и 93067 ("Барьер-1") ГНТП "АНФКС", направление "Сверхпроводимость".

### Список литературы

- [1] Wu X.D., Dye R.C., Muenchausen R.E. et al. // Appl. Phys. Lett. 1991. V. 58. N 19. P. 2165–2167.
- [2] Yoshimoto M., Syimozono K., Maeda T. et al. // Jpn. J. Appl. Phys. 1995. V. 34. N 6A. P. L688–L690.
- [3] Hollman E.K., Vendik O.G., Zaitsev A.G., Melekh B.T. // Supercond. Sci. Technol. 1994. V. 7. P. 609–622.
- [4] Chikyow T., Bedair S.M., Tye L., El-Masry N.A. // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 65. N 8. P. 1030–1032.
- [5] Inoue T., Yamamoto Y., Koyama S. et al. // Appl. Phys. Lett. 1990. V. 56. N 14. P. 1332–1333.
- [6] Inoue T., Osonoe M., Tohda H. et al. // J. Appl. Phys. 1991. V. 69. N 12. P. 8313–8315.
- [7] Inoue T., Ohsuna T., Obara Y. et al. // J. Cryst. Growth. 1993. V. 131. P. 347–351.
- [8] Смольский О.В., Денисов Д.В., Мамутин В.В. // Письма в ЖТФ. 1996 (в печати).

Физико-технический  
институт  
им. А.Ф.Иоффе РАН  
С.-Петербург

Поступило в Редакцию  
10 ноября 1995 г.